

**性能特点：**

- 频带：20~40GHz
- 插入损耗：0.8dB
- 隔离度：15dB
- 输入/输出电压驻波比：1.9/1.5
- 芯片尺寸：1.00mm×0.92mm×0.1mm

**产品简介：**

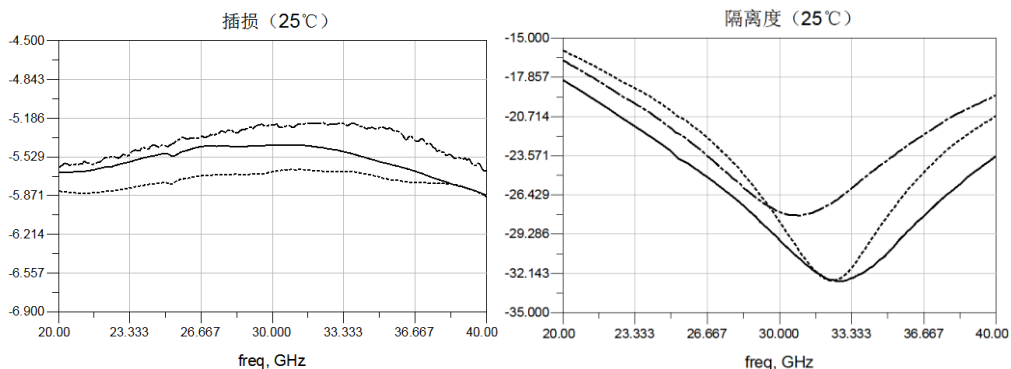
HH-PD32040 是一款 GaAs MMIC 0°三路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点，广泛应用于功率分配及合成。其频率范围覆盖 20~40GHz，带内插入损耗 0.8dB。

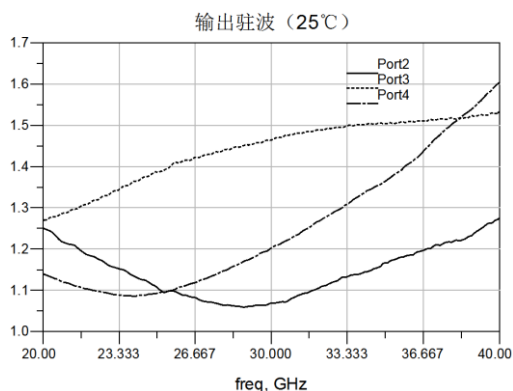
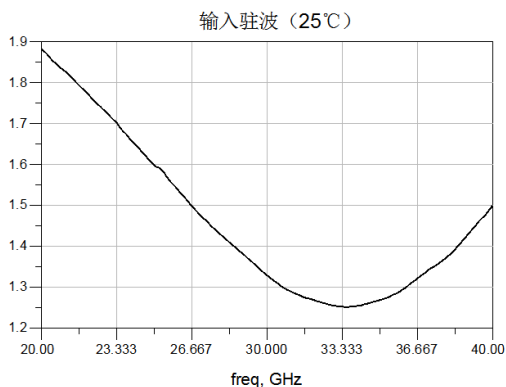
**电参数：(T<sub>A</sub>=25℃)**

| 指标      | 最小值   | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|---------|-------|-----|-----|-----|
| 频率范围    | 20~40 |     |     | GHz |
| 插入损耗    | -     | 0.8 | 1   | dB  |
| 隔离度     | -     | 15  | -   | dB  |
| 输入电压驻波比 | -     | 1.9 | -   | -   |
| 输出电压驻波比 | -     | 1.5 | -   | -   |

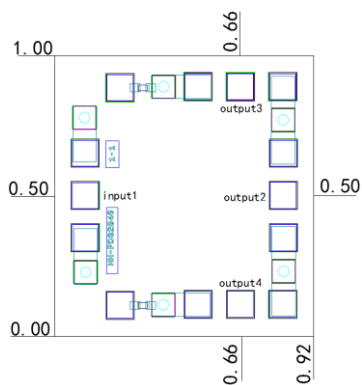
**使用限制参数：**

|      |           |
|------|-----------|
| 输入功率 | +15dBm    |
| 存储温度 | -65℃~150℃ |
| 使用温度 | -55℃~85℃  |

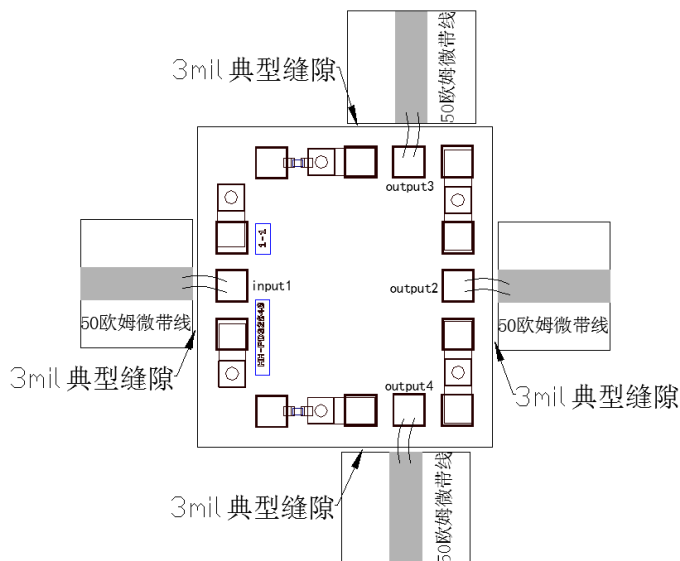
**典型曲线：**




尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



**使用说明：**

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。